



现？

答：公司半导体应用领域用的超硬材料磨具销售收入自第二季度开始逐渐恢复，同时得益于第三代半导体材料碳化硅的加工工具的增长，2023年前三季度，半导体应用领域用的超硬材料磨具销售收入与去年同期比已实现微幅增长。

**4.问：未来几年，发展前景和利润贡献比较大的业务有哪些？**

答：一是精密特种轴承业务，随着我国航天以及国防事业的发展，有望持续拉动该部分业务的增长；二是超硬材料磨具业务，较为看好在半导体封装领域进一步发展的机会；三是 MPCVD 法生产大单晶（多晶）金刚石业务，如果该部分业务的应用场景在未来逐步落地，将为整个金刚石行业的发展开辟新的较为广阔的发展空间。金刚石具有包括力学、光学、电学、声学 and 化学在内的许许多多其他材料无法比拟的优异性能，目前在工业上主要是利用了金刚石的力学性能，其他方面性能的应用国内外都在不断研究和探索。综合目前进展看，大单晶（多晶）金刚石业务方面，第一阶段产品为宝石级大单晶，当前已商业化；第二阶段产品是散热材料、光学窗口片等，该阶段的产品有望在未来 2-3 年实现商业化；第三阶段半导体材料是远期规划。

**5.问：六面顶压机今年的情况？**

答：由于超硬材料行业周期性和培育钻石行业波动，六面顶压机销售收入与同期相比有一定的下滑。

**6.问：公司贸易业务的收入规划？**

答：贸易业务的主要承担主体是公司全资子公司中机合作，中机合作系成立于 1981 年的我国磨料磨具行业专门进行进出口贸易的公司，贸易是该公司的主营业务。根据目前的发展状况和战略发展要求，中机合作未来将聚焦主业、转型发展、控制业务规模，在其三类业务中（第一类业务是自有产品的国际销售，第二类业务是公司所在业务领域的贸易业务，第三类业务为其他贸

	易业务), 重点发展第一类业务, 有序开展第二类业务, 严格控制第三类业务。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有, 可作为附件)	无